

AMAT Mirra Mesa

8 吋 CMP 標準作業程序

1. 檢查設備狀態 (設備 Alarm Message check)
2. 刷卡開機



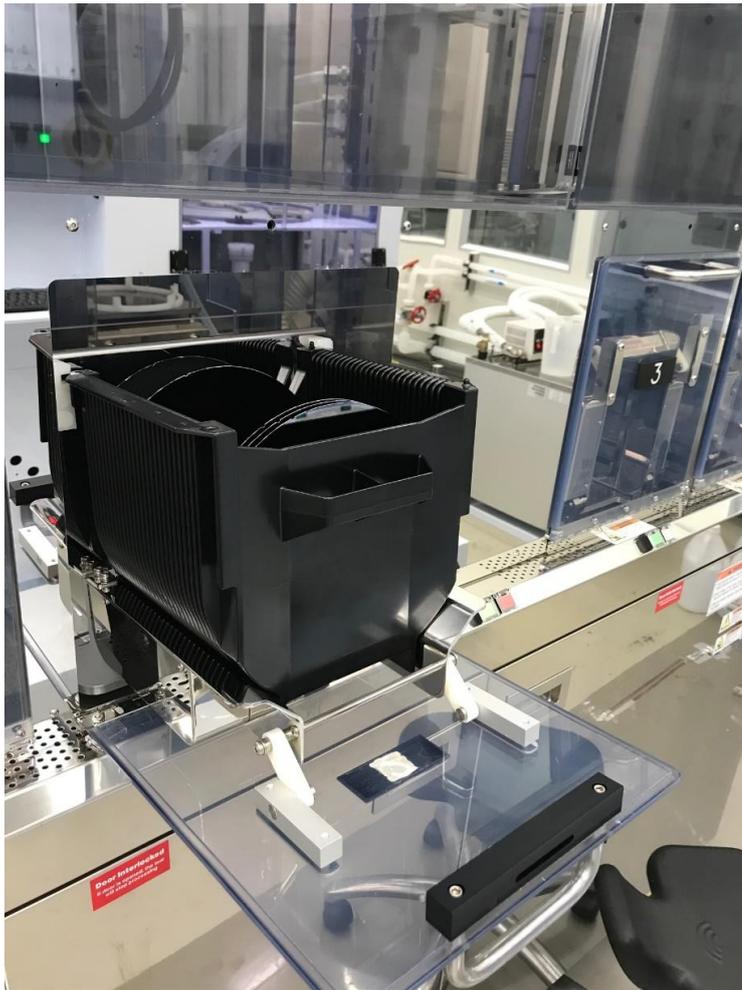
3. 配研磨液於研磨液供應系統(SDS)並切換 Si 或 SiO₂/SiN 之化學液供應系統 (CDS)模式

—請參閱 “[切換 Mega Chemical Tank SOP](#)” —



4. 暫停 Wet idle mode Process: STOP → Close

5. 按 Unload，放入 Cassette



6. 掃描 Cassette，選擇程式

- (1) 將需要研磨編輯 new 其餘編輯 disable
(Pad 1 使用於 Si 研磨；Pad 2 使用於 SiO₂/Si₃N₄ 研磨)
- (2) 選擇 Pad Conditioner 程式：通常使用” Dummy Condition “
- (3) 選擇研磨程式（剛剛建立好的程式）
- (4) OK

7. Start Processing → OK

參考資料

1. AMAT 美國應用材料

<https://www.appliedmaterials.com/zh-hant/products/mirra-mesa-cmp-200mm>

2. 逸典科技

<http://www.e-dot.com.tw/web/front/bin/home.phtml>